

INVESTOR RELATIONS

2022년 1월

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

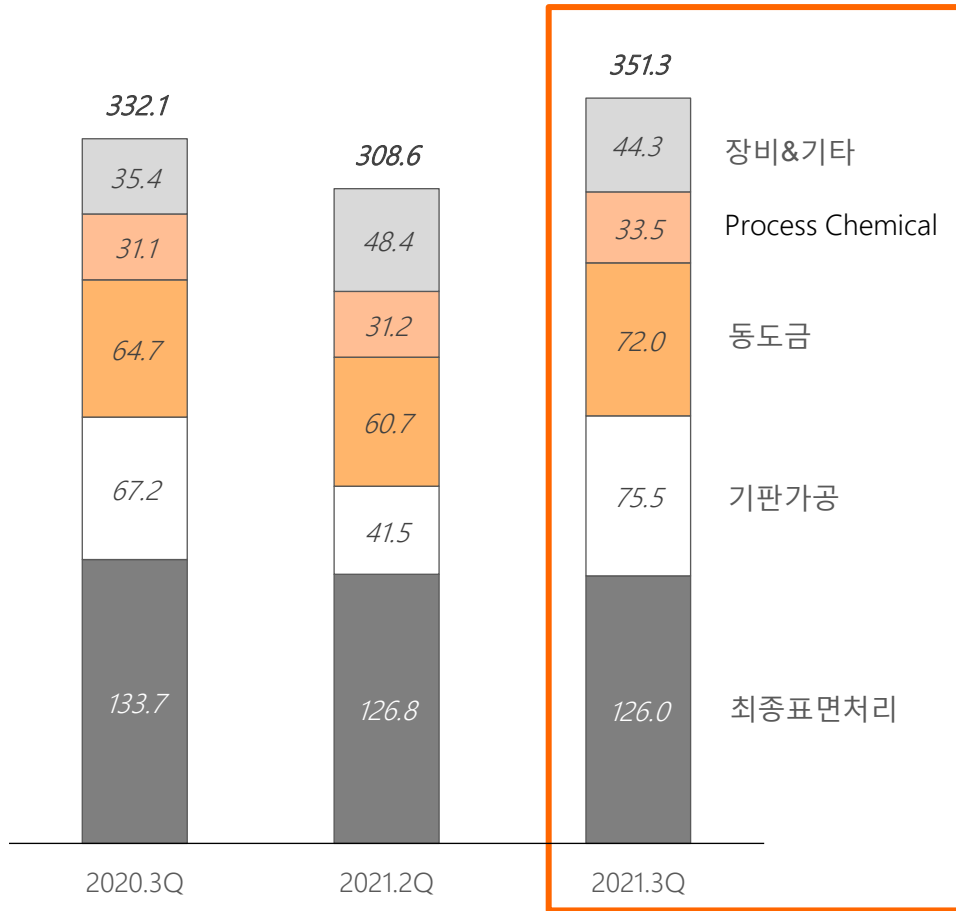
이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



2021년 Review

Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process Chemical □ 기타 및 장비 (단위:억원)



• 21년 3Q 매출액 351.3억원으로 역대 최대 매출 달성

- ✓ 20년 3Q 대비 19.2억원 / 5.8% 성장
- ✓ 실질적 매출 성장이 아닌 팔라듐 가격 & 상품(금)재료 판매로 인한 매출상승 (Pd가격/oz : 20년 3분기 \$2,168 → 21년 3분기 평균 \$2,459)

• Chemical 제품군 소폭 성장

- ✓ 최종표면처리 : 반도체 공급부족으로 인해 신규 북미모델의 양산지연, 이로 인해 중국 현지 FPCB 공급량 감소 (국내 RFPCB모델은 OLED용이며, 나머지 11~12개의 FPCB는 중국 local 업체가 공급)
- ✓ 동도금 : PKG 시장 매출 확대
- ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 대비 매출 상승

• 베트남 법인 및 기판가공 매출 확대

- ✓ 베트남: 20.3Q 94.4억원 → 21.3Q 100.5억원
- ✓ YPT: 20.3Q 41.1억원 → 21.3Q 46억원
- ✓ 베트남 법인 도금사업부 흑자전환

Income Statement

(단위:억원)

	제 23기 3분기	매출비중	제 22기 3분기	매출비중
I. 매출액	928.4	100%	818.0	100%
II. 매출원가	647.1	69.7%	521.0	63.7%
III. 매출총이익	281.3	30.3%	297.0	36.3%
판매비와 관리비	124.5	13.4%	109.6	13.4%
IV. 영업이익	156.8	16.9%	187.4	22.9%
금융수익	50.4	5.4%	24.5	3.0%
금융비용	48.0	5.2%	22.4	2.7%
기타수익	5.0	0.5%	6.1	0.7%
기타비용	2.8	0.3%	1.5	0.2%
지분법손익	0.0	0.0%	-1.4	-0.2%
V. 법인세차감전순이익	161.4	17.4%	192.7	23.6%
법인세비용	31.8	3.4%	25.4	3.1%
VI. 당기순이익	129.6	14.0%	167.3	20.5%

주요 수익성 지표

	제23기 3분기	제22기 3분기
영업이익률	16.9%	22.9%
순이익률	14.0%	20.5%
EBITDA (마진율)	207.0 (22.3%)	230.6 (28.2%)
ROE	8.6%	13.8%

Sales side

- ✓ 실질적 매출상승이 아닌 팔라뚝 가격 상승 & 금 원재료 판매로 인한 영업이익률 저하
- ✓ 3분기 중국 최종표면처리 출하량 감소

Cost side

- ✓ 코로나 바이러스로 인한 유럽 & 중국 원재료 가격 대폭 상승
- ✓ 인원투자 (극동박 & 마스크)

2022 Preview

PCB Industry

PCB : Printed Circuit Board의 약자로 인쇄회로기판을 의미

구리 배선이 가능하게 인쇄된 판으로, 반도체, 컨덴서, 저항 등 각종 부품을 실장 할 수 있게 되어있으며 부품 상호간의 연결구실을 하는 모듈



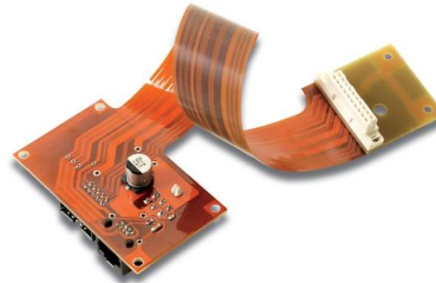
RIGID PCB

RIGID 즉, 경성화 된 일반적인 PCB



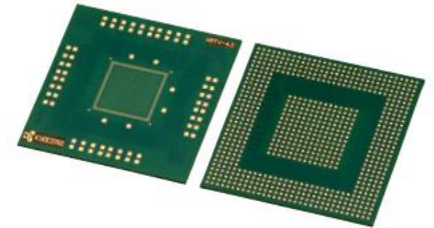
HDI

고밀도인쇄회로기판 (주로 휴대폰 메인기판)



FPCB / RFPCB

FCCL을 사용하여 휘어지는 특성을 가지는 PCB

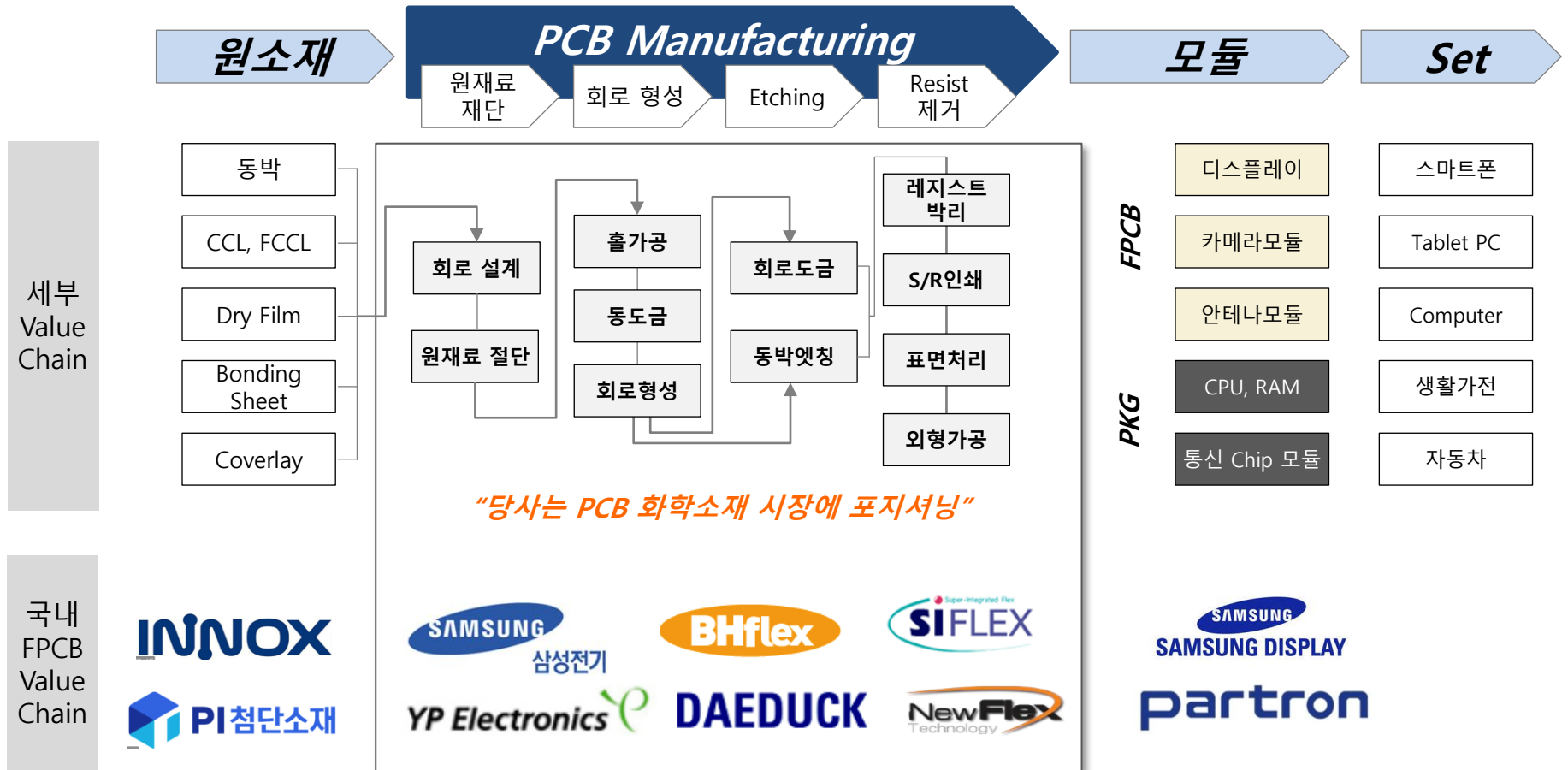


PKG Substrate

반도체 실장용 PCB

주요 Business 영역

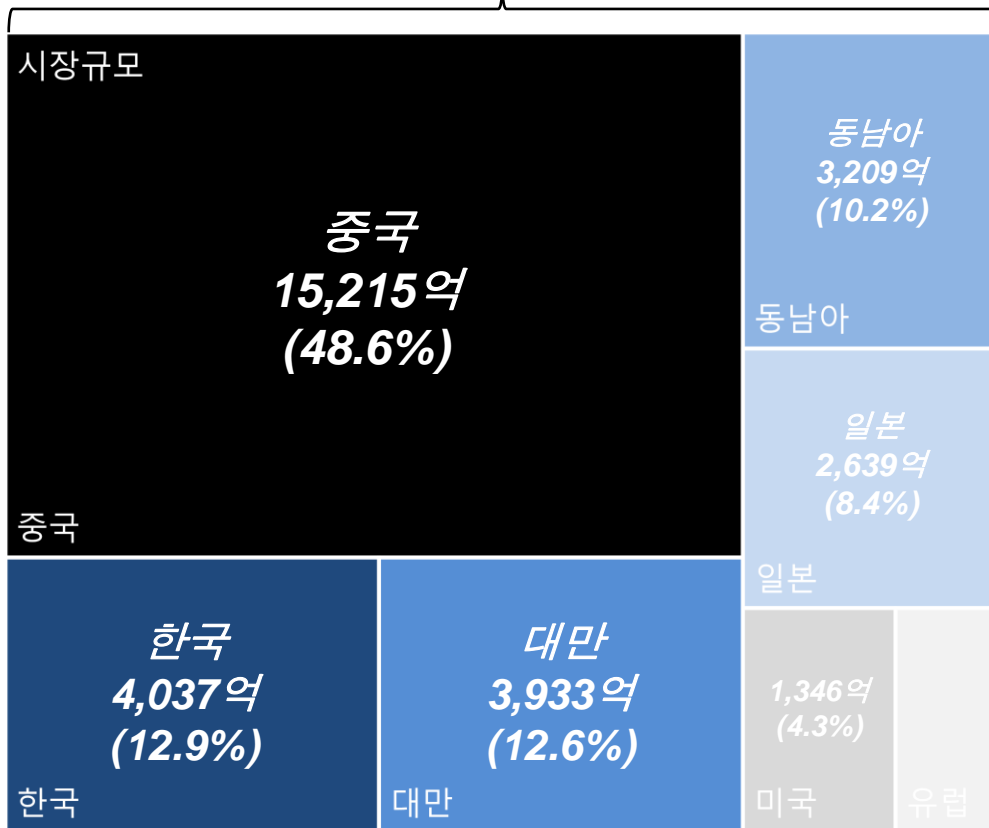
PCB Industry value chain



PCB Chemical Market

PCB 제조 상 화학소재는 전체 생산액의 4~5% 정도로 추정하고 있으며, 이에 Global PCB 화학소재 시장은 약 3조원 시장으로 파악되고 있음. 시장 또한 유럽 및 일본의 소수의 Player가 특정 공정상의 분야를 대부분 점유하고 있는 과점 시장의 형태를 띄고 있음

시장규모 약 3조원



Global Major Player



- 전체매출 : 7,300억원(PCB분야)
- 시장점유율 : 24%
- 주요제품 : 동도금



- 전체매출 : 6,000억원
- 시장점유율 : 20%
- 주요제품 : 전기동도금 등



- 전체매출 : 5,000억원
- 시장점유율 : 17%
- 주요제품 : Soft ENIG, ENEPIG 및 전기동



- 전체매출 : 3,000억원
- 시장점유율 : 10%
- 주요제품 : ENIG

(SOURCE : 당사 분석, 각 회사 Annual Report, KPCA 협회 연간 리포트)

	소재	가공 (화학소재 공정)				최종제품
		Hole 가공	화학동도금	전기동도금	최종표면처리	
RIGID	<ul style="list-style-type: none"> • 동박, ccl, dry film 등 대부분의 소재를 중국 local 업체들이 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 업체 • 일부 작은 규모의 국내 업체도 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 및 국내업체 		<ul style="list-style-type: none"> • ENIG : 와이엠티 및 일본, 중국업체 경쟁 	<ul style="list-style-type: none"> • 일반적인 초록색 기판의 PCB
FPCB	<ul style="list-style-type: none"> • 동박 : 중국 장춘 등 • FCCL : 이녹스, 중국등 	<ul style="list-style-type: none"> • 당사를 비롯하여 한국, 중국, 일본 업체가 경쟁중 	<ul style="list-style-type: none"> • 국내 : 와이엠티, 오알켄 • 해외: 아토텍, 다우 	<ul style="list-style-type: none"> • 고사양 RFPCB 적용중으로 미국의 맥더미드가 대부분 점유 	<ul style="list-style-type: none"> • SOFT ENIG & ENEPIG : 당사와 일본의 우에무라 경쟁 	<ul style="list-style-type: none"> • 안테나, 모듈 등에 적용되는 휘어지는 PCB
PKG	<ul style="list-style-type: none"> • 동박 : mSAP 공정용 동박은 일본의 MITSUI가 100% 점유 • 기타 소재 또한 듀폰 등 해외 대기업이 점유 	<ul style="list-style-type: none"> • 일본(스미토모, 삼영순화, 시코쿠), 유럽(아토텍), 미국기업의 시장 	<ul style="list-style-type: none"> • 아토텍이 대부분 점유하고 있는 시장 	<ul style="list-style-type: none"> • 미국의 맥더미드, 일본의 에바라, 아토텍 등 외산 기업 시장 	<ul style="list-style-type: none"> • ENIG & ENEPIG 등: 우에무라가 대부분 점유 	<ul style="list-style-type: none"> • CSP, FC-BGA, BGA 등 반도체 실장용 PCB

현재 진입하여 양산매출(S사, T사) 발생중

고객사 승인 및 양산성 확인 22년 매출 발생 기대

현재 PKG 고객사들의 큰 규모의 투자가 이루어지고 있는 바, 이는 당사에게 장단기적으로 성장의 모멘텀으로 작용 전망 다수의 고객사들과 현재 프로세스 공급을 논의중에 있으며 기존 약품 외에도 신규 프로세스 도입 예상

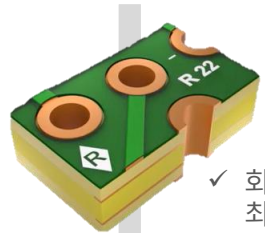
** PKG 프로세스의 경우 END USER의 승인이 일반적으로 요구됨.*

	MOBILE	PKG	Auto Mobile
최종표면처리	<ul style="list-style-type: none"> 베트남, 중국 업체 추가 예상하고 있으나 점유율 1위로 소폭 성장 전망 	<ul style="list-style-type: none"> 아직 매출이 나오지 않는 시장으로 매출 가능성 및 성장성 높음 	<ul style="list-style-type: none"> <u>북미고객사 대상으로 매출이 발생중이며, 22년 성장 전망</u>
동도금	<ul style="list-style-type: none"> 무전해 화학동 	<ul style="list-style-type: none"> RFPCB 시장의 점유율이 높으나, 휴대폰 시장의 성장률이 저조하기 때문에 성장률은 낮을 것 	<ul style="list-style-type: none"> <u>현재 2곳의 고객사를 거래중으로 22년 다수의 고객사 추가 전망</u>
	<ul style="list-style-type: none"> 전기동 	<ul style="list-style-type: none"> RFPCB용 전기동 시장 진입 전망 (현재 미국 M사가 대부분 점유) 	<ul style="list-style-type: none"> <u>양산 매출 발생중으로 고객사 확대 영업</u>
Process Chemical	<ul style="list-style-type: none"> 소폭 성장 전망 	<ul style="list-style-type: none"> 양산 매출 발생중으로 고객사 확대 영업 	<ul style="list-style-type: none"> -
외주가공	<ul style="list-style-type: none"> 전기동 (via-fill) 외주 확대 (국내 및 베트남) 22년 하반기 중국 법인 외주가공 영업 (상반기 화학약품, 하반기 외주공장 set-up) 		
소재	<ul style="list-style-type: none"> 현재 극동박은 국책과제로 수요기업 및 국내최대 동박회사와 협업중 EMI 차폐 소재 확판 노력 		
신사업 & 기타	<ul style="list-style-type: none"> 21년 상사 법인 에스피머티리얼즈 설립, 22년 매출 발생 전망(알루미늄박, 전자소재 등) B2C 매출 발생 확대 (아이테라, 엘라실드) / 중국, 일본 시장 진출 송도 공장 착공 준비 24년 완공 목표 (바이오 원단 및 극동박 파일럿 라인, 화학소재 연구소 등) 		

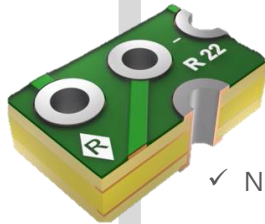
Appendix

Products Introduction – Finish Plating

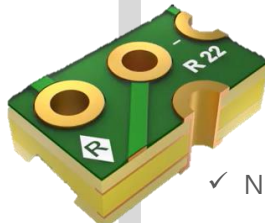
최종표면처리



✓ 회로형성, 적층 등 최종단계의 기판



✓ Nickel 도금



✓ Nickel위에 금도금

동도금

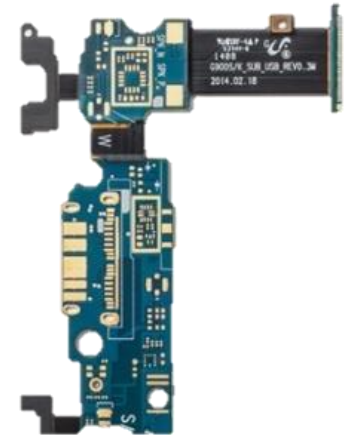


- ✓ 수세, 소프트에칭, 프리딥 등의 프로세스를 거쳐 최종적으로 구리 표면 위 **니켈-금 순서로 도금**을 진행
- ✓ 와이엠티는 금이 도금될 수 있는 약품, 첨가제들을 고객사로 납품하고 있음 [금은 PCB 제조사에서 직접 구매 진행]

Process Chemical

Electronic Materials

금도금 후 최종기판



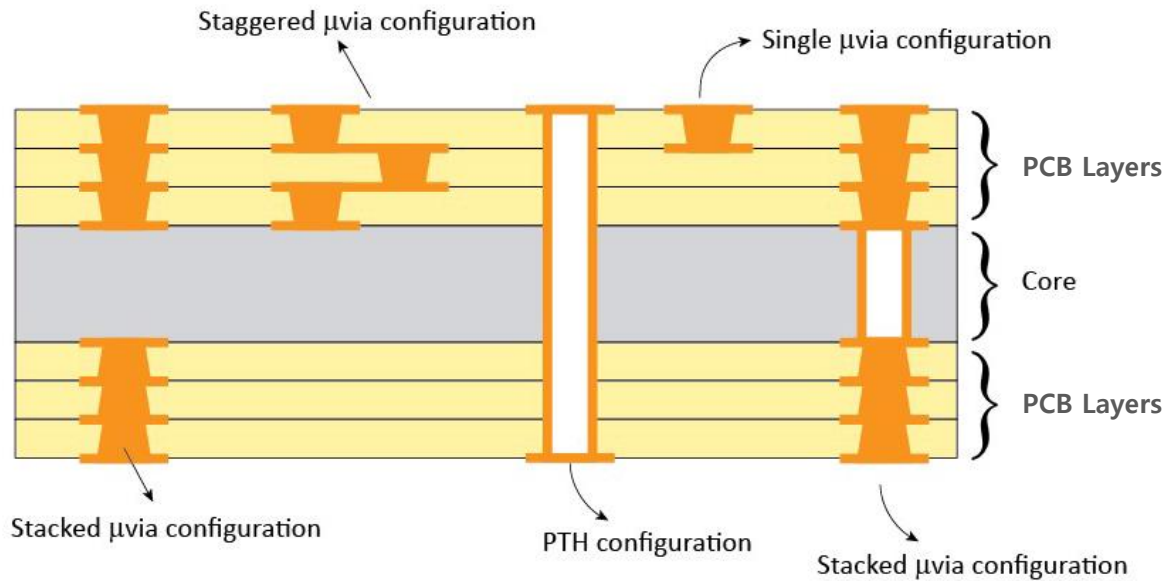
Products Introduction – Copper Plating Chemical

최종표면처리

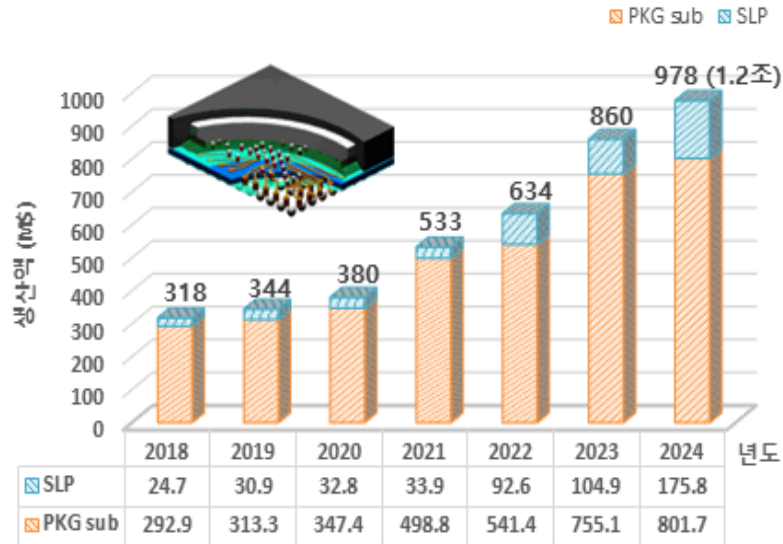
동도금

Process Chemical

Electronic Materials



동박 (Ultra thin copper foil)



[이형동박 글로벌 시장 규모]

* Ref: Yole, 2018-2024 Advanced packaging revenue forecast (2019)
 * Ref: PS Electronics, SLP - The highlight in the future PCB industry (2020)
 * Ref: 한국전자회로산업협회, 2019 일렉트로닉스 실장 신소재 편람 (2019)
 * SLP : Substrate Like PCB

두께	주요업체	용도	시장특징
1um~3um	일본 1개사	<ul style="list-style-type: none"> PKG mSAP SLP 	Global 독점
6um	국내 동박 대기업	<ul style="list-style-type: none"> 전기차 음극재 PCB 	한국 동박회사 중심
10um~	중국 중심 국내 일부	<ul style="list-style-type: none"> 일반 PCB 	경쟁시장

극동박 시장의 성장 이유

- 기존 공법은 노광을 하고 구리를 에칭하여 회로를 형성하는데 Under cut 이슈로 사다리꼴 모양의 회로 형성 (Negative)
- mSAP, SAP는 극동박위에 노광을 진행하고 그 사이를 전기동도금하여 패턴을 형성하는 방법으로 직각으로 회로가 형성되어 사다리꼴보다 미세하게 회로를 형성 가능



• NUINUA 마스크 런칭



차단을 넘어, 살균!

필터의 차이가 기술의 차이.
원리부터 다릅니다.